

2019-2025年中国集成电路 市场深度调查与投资前景分析报告

报告目录及图表目录

中国产业研究报告网 编制

www.chinairr.org

一、报告报价

《2019-2025年中国集成电路市场深度调查与投资前景分析报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.chinairr.org/report/R06/R0602/201908/21-310334.html>

产品价格：纸介版9800元 电子版9800元 纸介+电子10000元

订购电话: 400-600-8596 010-80993936

传真: 010-60343813

网址: <http://www.chinairr.org>

Email: sales@chyxx.com

联系人：刘老师 陈老师 谭老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

集成电路（integrated circuit）是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构；其中所有元件在结构上已组成一个整体，使电子元件向着微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面迈进了一大步。它在电路中用字母“IC”表示。集成电路发明者为杰克·基尔比（基于锗（Ge）的集成电路）和罗伯特·诺伊思（基于硅（Si）的集成电路）。当今半导体工业大多数应用的是基于硅的集成电路。2018年2-10月中国集成电路各月当月产量及累计产量走势

中国产业研究报告网发布的《2019-2025年中国集成电路市场深度调查与投资前景分析报告》共十六章。首先介绍了中国集成电路行业市场发展环境、集成电路整体运行态势等，接着分析了中国集成电路行业市场运行的现状，然后介绍了集成电路市场竞争格局。随后，报告对集成电路做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国集成电路行业发展趋势与投资预测。您若想对集成电路产业有个系统的了解或者想投资中国集成电路行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 集成电路基本情况

1.1 集成电路的相关介绍

1.1.1 集成电路概念

1.1.2 集成电路行业

1.2 集成电路产品流程及产业链结构

1.2.1 集成电路产品流程

1.2.2 集成电路产业链结构

第二章 2014-2018年集成电路发展环境分析

2.1 宏观经济环境

- 2.1.1 全球经济发展形势
- 2.1.2 中国宏观经济概况
- 2.1.3 中国工业运行情况
- 2.1.4 中国经济发展展望
- 2.2 政策环境分析
 - 2.2.1 产业相关政策汇总
 - 2.2.2 企业免税政策分析
 - 2.2.3 产业的国家发展战略
 - 2.2.4 “十三五”发展规划
- 2.3 产业发展环境
 - 2.3.1 电子信息产业与集成电路
 - 2.3.2 智能化带动集成电路发展
 - 2.3.3 区块链发展带来产业新增量

第三章 2014-2018年半导体所属行业发展分析

- 3.1 2014-2018年全球半导体行业分析
 - 3.1.1 半导体市场发展规模
 - 3.1.2 半导体产业区域分析
 - 3.1.3 半导体产品结构分析
 - 3.1.4 半导体与集成电路
- 3.2 2014-2018年中国半导体行业分析
 - 3.2.1 产业发展态势
 - 3.2.2 产业规模现状
 - 3.2.3 市场发展动力
 - 3.2.4 产业发展趋势
- 3.3 2014-2018年半导体材料行业分析
 - 3.3.1 半导体材料的重要意义
 - 3.3.2 半导体材料行业的特点
 - 3.3.3 全球半导体材料市场
 - 3.3.4 中国半导体材料市场
 - 3.3.5 中国半导体材料国产化
 - 3.3.6 半导体材料与集成电路

第四章 2014-2018年全球集成电路产业发展分析

4.1 全球集成电路产业分析

4.1.1 全球销售规模分析

4.1.2 全球产品结构分析

4.1.3 全球细分市场规模

4.2 美国集成电路产业分析

4.2.1 产业发展概况

4.2.2 产业发展模式

4.2.3 产业技术计划

4.3 台湾集成电路产业分析

4.3.1 产业发展基本情况

4.3.2 IC设计业发展现状

4.3.3 晶圆代工业发展现状

4.3.4 封装测试业发展现状

4.4 其他国家集成电路产业分析

4.4.1 韩国集成电路产业概况

4.4.2 日本集成电路产业分析

第五章 2014-2018年中国集成电路产业发展分析2018-2024年中国集成电路产量走势

5.1 集成电路产业发展综述

5.1.1 产业发展历程

5.1.2 产业发展意义

5.2 集成电路产业运行规模分析

5.2.1 市场销售规模

5.2.2 进口规模分析

5.2.3 出口规模分析

5.2.4 产业结构分析

5.3 集成电路市场竞争分析

5.3.1 行业进入壁垒的提高

5.3.2 上游行业垄断程度高

5.3.3 行业内竞争持续加剧

- 5.3.4 企业盈利能力增强
- 5.3.5 研发投入持续增长
- 5.4 集成电路产业发展问题及发展策略
 - 5.4.1 产业发展问题
 - 5.4.2 产业发展策略
- 5.5 集成电路产业核心竞争力提升方法
 - 5.5.1 提高扶持资金集中运用率
 - 5.5.2 制定融资投资制度
 - 5.5.3 提高政府采购力度
 - 5.5.4 建立技术中介服务制度
 - 5.5.5 人才引进与人才培养

第六章 2014-2018年中国集成电路主要城市分析

- 6.1 北京
 - 6.1.1 产业发展现状
 - 6.1.2 产业市场规模
 - 6.1.3 产业发展特点
 - 6.1.4 产业发展瓶颈
 - 6.1.5 产业发展对策
- 6.2 上海
 - 6.2.1 产业发展规模
 - 6.2.2 产业发展预测
 - 6.2.3 技术发展预测
 - 6.2.4 产业发展思路
 - 6.2.5 发展措施及建议
- 6.3 深圳
 - 6.3.1 产业政策环境
 - 6.3.2 产业发展现状
 - 6.3.3 产业发展规模
 - 6.3.4 产业发展目标
 - 6.3.5 产业发展动态
- 6.4 杭州

- 6.4.1 产业发展背景
- 6.4.2 行业发展现状
- 6.4.3 行业发展问题
- 6.4.4 发展对策建议
- 6.5 厦门
 - 6.5.1 产业发展政策
 - 6.5.2 产业发展规模
 - 6.5.3 产业优劣势分析
 - 6.5.4 产业发展建议
- 6.6 其他
 - 6.6.1 江苏
 - 6.6.2 湖南
 - 6.6.3 湖北武汉
 - 6.6.4 安徽合肥
 - 6.6.5 广东珠海

第七章 2014-2018年集成电路行业产品介绍

- 7.1 微处理器（MPU）
 - 7.1.1 CPU
 - 7.1.2 AP（APU）
 - 7.1.3 GPU
 - 7.1.4 MCU
 - 7.1.5 DSP
- 7.2 存储器
 - 7.2.1 存储器发展规模
 - 7.2.2 动态随机存取存储器（DRAM）
 - 7.2.3 存储器市场需求分析
 - 7.2.4 存储器市场份额划分
 - 7.2.5 存储器在手机中的应用
- 7.3 NAND Flash（NAND闪存）
 - 7.3.1 全球NAND Flash市场规模
 - 7.3.2 全球闪存的主要供应厂商

7.3.3 全球闪存的技术发展

7.3.4 全球主要厂商表现

7.4 其他细分市场产品

7.4.1 存储芯片

7.4.2 逻辑芯片

7.4.3 处理芯片

7.4.4 模拟芯片

第八章 2014-2018年集成电路行业细分——集成电路设计业

8.1 集成电路设计介绍

8.2 集成电路设计业市场发展分析

8.2.1 行业销售规模

8.2.2 区域发展格局

8.2.3 主要城市分析

8.3 集成电路设计企业规模分析

8.3.1 设计企业规模

8.3.2 企业区域格局分析

8.3.3 企业从业人员规模

8.3.4 主要企业销售规模

8.3.5 各领域企业的规模

8.4 集成电路设计产业园区介绍

8.4.1 辽宁集成电路设计产业基地

8.4.2 北京中关村集成电路设计园

8.4.3 深圳集成电路设计应用产业园

第九章 2014-2018年集成电路行业核心——集成电路制造业

9.1 集成电路制造业发展情况分析

9.1.1 集成电路制造业基本概念

9.1.2 集成电路制造业增长原由

9.1.3 集成电路制造业重要性

9.1.4 集成电路制造业工艺技术

9.2 集成电路制造业发展规模分析

- 9.2.1 市场发展规模分析
- 9.2.2 主要企业销售规模
- 9.2.3 市场投资建设规模
- 9.3 集成电路制造业发展问题分析
 - 9.3.1 市场份额较低
 - 9.3.2 产业化进程缓慢
 - 9.3.3 缺乏复合型人才
- 9.4 集成电路制造业发展思路及建议
 - 9.4.1 国家和地区设计有机结合
 - 9.4.2 坚持密切贴合产业链需求
 - 9.4.3 产业体系生态建设与完善
 - 9.4.4 依托相关政策推动国产化
 - 9.4.5 整合力量推动创新发展

第十章 2014-2018年集成电路行业细分——晶圆制造业

- 10.1 晶圆制造行业发展综述
 - 10.1.1 晶圆制造行业概述
 - 10.1.2 晶圆制造工艺分析
 - 10.1.3 晶圆加工技术介绍
- 10.2 全球晶圆制造业市场发展情况分析
 - 10.2.1 全球晶圆产能格局
 - 10.2.2 全球晶圆消费格局
 - 10.2.3 企业竞争情况分析
- 10.3 中国晶圆制造市场发展情况分析
 - 10.3.1 中国晶圆生产线规模
 - 10.3.2 中国晶圆设备的需求
 - 10.3.3 中国晶圆工厂的分布
- 10.4 晶圆制造行业发展趋势分析
 - 10.4.1 全球市场发展趋势
 - 10.4.2 全球市场发展预测
 - 10.4.3 中国市场发展预测

第十一章 2015-2018年集成电路行业细分——封装测试业

11.1 集成电路封装测试行业发展综述

11.1.1 封装测试业发展概况

11.1.2 封装测试业的重要性

11.1.3 封装测试行业竞争特征

11.2 中国集成电路封装测试市场发展分析

11.2.1 市场发展态势分析

11.2.2 市场发展规模分析

11.2.3 主要企业收入规模

11.3 集成电路封装测试业技术发展分析

11.3.1 技术最新发展情况

11.3.2 未来产品的发展趋势

11.3.3 存在的技术挑战

11.4 先进封装与系统集成创新平台

11.4.1 中心基本情况

11.4.2 中心基础建设

11.4.3 中心服务状况

11.4.4 中心创新机制

11.4.5 中心专利成果

第十二章 2014-2018年集成电路其他相关行业分析

12.1 2014-2018年传感器行业分析

12.1.1 行业发展基本态势

12.1.2 全球行业发展规模

12.1.3 全球市场竞争格局

12.1.4 中国市场发展规模

12.1.5 中国市场竞争格局

12.1.6 行业未来发展趋势

12.2 2014-2018年分立器件行业分析

12.2.1 行业的发展概况

12.2.2 行业的发展现状

12.2.3 分立器件市场规模

- 12.2.4 产业链上游分析
- 12.2.5 产业链下游分析
- 12.2.6 主要供应商分析
- 12.3 2014-2018年光电器件行业分析
 - 12.3.1 行业政策环境
 - 12.3.2 行业发展现状
 - 12.3.3 行业产量规模
 - 12.3.4 发展问题及挑战
 - 12.3.5 行业发展策略
- 12.4 2014-2018年芯片行业发展分析
 - 12.4.1 全球市场规模
 - 12.4.2 中国产业规模
 - 12.4.3 中国市场需求
 - 12.4.4 产业发展困境
 - 12.4.5 发展应对策略
- 12.5 2014-2018年硅片产业发展分析
 - 12.5.1 硅片市场发展现状
 - 12.5.2 硅片市场供需情况
 - 12.5.3 硅片市场发展机遇
 - 12.5.4 硅片与集成电路的关系

第十三章 2014-2018年集成电路技术分析

- 13.1 集成电路技术综述
 - 13.1.1 技术联盟成立
 - 13.1.2 技术应用分析
- 13.2 集成电路前道制造工艺技术
 - 13.2.1 微细加工技术
 - 13.2.2 电路互联技术
 - 13.2.3 器件特性的退化
- 13.3 集成电路后道制造工艺技术
 - 13.3.1 3D集成技术
 - 13.3.2 晶圆级封装

- 13.4 集成电路的ESD防护技术
 - 13.4.1 集成电路的ESD现象成因
 - 13.4.2 集成电路ESD的防护器件
 - 13.4.3 基于SCR的防护技术分析
 - 13.4.4 集成电路全芯片的防护技术
- 13.5 集成电路技术发展趋势及前景展望
 - 13.5.1 技术发展趋势
 - 13.5.2 技术发展前景
 - 13.5.3 技术市场展望

第十四章 2014-2018年集成电路应用市场发展分析

- 14.1 汽车工业
 - 14.1.1 汽车工业产销状况分析
 - 14.1.2 汽车工业进出口状况分析
 - 14.1.3 汽车工业经济效益分析
 - 14.1.4 集成电路在汽车的应用状况
- 14.2 通信行业
 - 14.2.1 通信业总体情况
 - 14.2.2 通信业网络设施
 - 14.2.3 集成电路应用状况
- 14.3 消费电子
 - 14.3.1 消费电子市场发展状况
 - 14.3.2 智能手机集成电路应用分析
 - 14.3.3 电源管理IC市场分析
 - 14.3.4 消费电子类集成电路技术分析
- 14.4 医学应用
 - 14.4.1 医学的应用概况
 - 14.4.2 便携式医疗仪器
 - 14.4.3 可穿戴式医疗仪器
 - 14.4.4 植入式医疗仪器
 - 14.4.5 仿生器官芯片
 - 14.4.6 医学应用发展趋势

第十五章 国外集成电路产业重点企业经营分析

15.1 英特尔 (Intel)

15.1.1 企业发展概况

15.1.2 企业经营状况分析

15.2 亚德诺 (ADI)

15.2.1 企业发展概况

15.2.2 企业经营状况分析

15.3 SK海力士 (SKhynix)

15.3.1 企业发展概况

15.3.2 企业经营状况分析

15.4 恩智浦 (NXP Semiconductors N.V.)

15.4.1 企业发展概况

15.4.2 企业经营状况分析

15.5 德州仪器 (TEXAS INSTRUMENTS INC)

15.5.1 企业发展概况

15.5.2 企业经营状况分析

15.6 英飞凌 (Infineon Technologies AG)

15.6.1 企业发展概况

15.6.2 企业经营状况分析

15.7 意法半导体集团 (STMicroelectronics)

15.7.1 企业发展概况

15.7.2 企业经营状况分析

第十六章 中国集成电路产业重点企业经营分析

16.1 中芯国际集成电路制造有限公司

16.1.1 企业发展简况分析

16.1.2 企业经营情况分析

16.1.3 企业经营优劣势分析

16.2 杭州士兰微电子股份有限公司

16.2.1 企业发展简况分析

16.2.2 企业经营情况分析

- 16.2.3 企业经营优劣势分析
- 16.3 上海贝岭股份有限公司
 - 16.3.1 企业发展简况分析
 - 16.3.2 企业经营情况分析
 - 16.3.3 企业经营优劣势分析
- 16.4 江苏长电科技股份有限公司
 - 16.4.1 企业发展简况分析
 - 16.4.2 企业经营情况分析
 - 16.4.3 企业经营优劣势分析
- 16.5 吉林华微电子股份有限公司
 - 16.5.1 企业发展简况分析
 - 16.5.2 企业经营情况分析
 - 16.5.3 企业经营优劣势分析
- 16.6 中电广通股份有限公司
 - 16.6.1 企业发展简况分析
 - 16.6.2 企业经营情况分析
 - 16.6.3 企业经营优劣势分析

第十七章 2014-2018年集成电路产业投融资分析

- 17.1 集成电路产业投融资环境分析
 - 17.1.1 产业固定资产投资规模
 - 17.1.2 产业设立投资基金
 - 17.1.3 产业项目建设情况
- 17.2 集成电路行业投资特性分析
 - 17.2.1 周期性
 - 17.2.2 区域性
 - 17.2.3 特有模式
 - 17.2.4 资金密集性
 - 17.2.5 其他特性
- 17.3 集成电路产业投资基金分析
 - 17.3.1 北京产业基金
 - 17.3.2 上海产业基金

- 17.3.3 广东产业基金
- 17.3.4 陕西产业基金
- 17.3.5 其他区域基金
- 17.4 集成电路产业投资机遇分析
 - 17.4.1 万物互联形成战略新需求
 - 17.4.2 人工智能开辟技术新方向
 - 17.4.3 协同开放构建研发新模式
 - 17.4.4 新旧力量塑造竞争新格局

第十八章 2019-2025年集成电路产业发展趋势及前景预测（ZY GXH）

- 18.1 集成电路产业发展趋势分析
 - 18.1.1 产业发展战略布局
 - 18.1.2 产业发展趋势变化
 - 18.1.3 产业模式变化分析
- 18.2 集成电路产业发展前景预测
 - 18.2.1 全球市场发展预测
 - 18.2.2 2019-2025年中国集成电路市场发展规模预测（ZY GXH）

图表目录：

- 图表 集成电路完整产品流程图
- 图表 集成电路完整产业链结构
- 图表 2013-2018年国内生产总值及其增长速度
- 图表 2013-2018年三次产业增加值占全国生产总值比重
- 图表 2012-2018年全部工业增加值及其增速
- 图表 中国集成电路行业主要政策汇总
- 图表 《国家集成电路产业发展推进纲要》发展目标
- 图表 《中国集成电路产业“十三五”发展规划建议》发展目标
- 图表 2008-2018年全球半导体市场规模及增速
- 图表 2018年半导体销售额分地区占比
- 图表 2018年半导体分地区销售额增速
- 图表 2018年全球半导体产品结构
- 图表 2018年半导体市场分类增速

更多图表见正文……

详细请访问：<http://www.chinairr.org/report/R06/R0602/201908/21-310334.html>